

# WEICON Easy-Mix HT 250 Epoxy Adhesive



**Ketahanan suhu yang sangat tinggi hingga +200 ° C (+392 ° F), sebentar hingga +250 ° C (+482 ° F), daya rekat tinggi pada logam, konduktivitas termal yang tinggi, dan ketahanan yang tinggi terhadap media agresif dan pelapis bubuk**

WEICON Easy-Mix HT 250 adalah perekat 2 komponen berdasarkan resin epoksi dengan ketahanan suhu tinggi hingga +200 ° C; secara singkat hingga +250 ° C. Sistem resin epoksi 2-C menunjukkan daya rekat yang sangat tinggi pada logam dan fiberglass. Kesesuaian yang sangat baik untuk aplikasi khusus ditunjukkan oleh konduktivitas termal yang tinggi dikombinasikan dengan ketahanan suhu tinggi. Perekat mempertahankan lebih dari 80% kekuatannya bahkan pada suhu yang terus menerus tinggi. Hal ini memungkinkan pengikatan komponen, yang dilapisi thermo-coated (dilapisi bubuk) setelah pengawetan. Perekat resin epoksi memiliki ketahanan yang tinggi terhadap zat agresif, seperti air panas dan dingin, oli motor, dan glikol. Untuk aplikasi produk Easy-Mix, diperlukan Dispenser Easy-Mix D 50.

## Karakteristik

Tekstur	kental
Warna	abu-abu muda
Umur simpan minimum	pada suhu ruang

## Pengolahan

Suhu pengawetan	+10 ° C - +50 ° C
Rasio pencampuran berdasarkan volume	2:1
Viskositas campuran	pada suhu 20 ° C
Kepadatan campuran	38.000 mPa-s

2,1 g/cm<sup>3</sup>

Menjembatani celah hingga maksimal.

## Pengawetan

Kehidupan pot	pada suhu 20 ° C, batch 10 ml	150 menit.
Kekuatan kerja setelah	(Kekuatan 50%)	8 h
Kekuatan akhir	(Kekuatan 100%)	24 (30 min.   80°C) h

## Sifat mekanis setelah pengawetan

Kekuatan tarik	DIN EN ISO 527-2	50 MPa
Perpanjangan putus (tarik)	DIN EN ISO 527-2	2.9 %
Kekerasan (Shore D)	DIN ISO 7619	> 90
Tebal bahan kekuatan geser lap. 1,5mm DIN EN 1465		
Baja, 1,0338 sandblasted	20 N/mm <sup>2</sup>	
Aluminium sandblasted	15 N/mm <sup>2</sup>	
ABS	6 N/mm <sup>2</sup>	
PC (polikarbonat)	4 N/mm <sup>2</sup>	
GFRP	10 N/mm <sup>2</sup>	

## Parameter termal

Tg setelah pengawetan pada suhu kamar	(DSC)	~ +65 ° C
Tg setelah temper (pada suhu 80 ° C)	(DSC)	+130 ° C
Koefisien ekspansi termal	ISO 11359	5·10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup> 1/m-K

Konduktivitas termal

Parameter listrik		
Kekuatan dielektrik	DIN EN 60243-1 (20°C)	>24 kV / mm

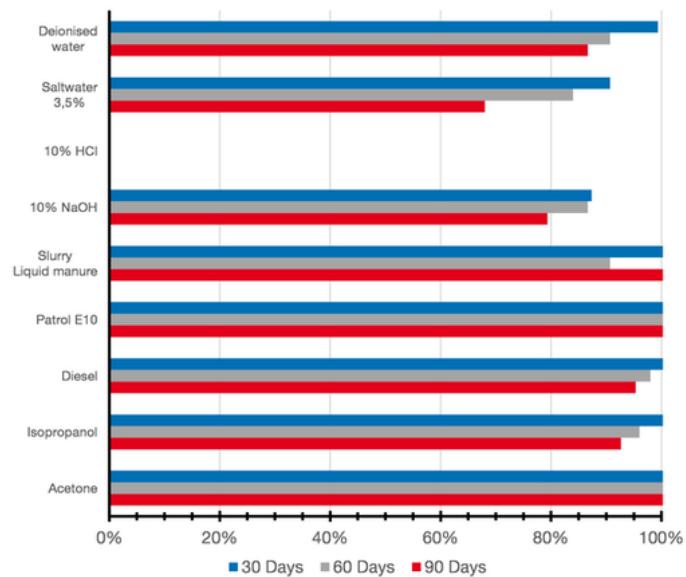
## Persetujuan / Pedoman

Spesifikasi MIL	mematuhi	MIL-A-47284A
-----------------	----------	--------------

## Petunjuk penggunaan

Saat menggunakan produk WEICON, data dan peraturan fisik, terkait keselamatan, toksikologi, dan ekologi dalam lembar data keselamatan EC (www.weicon.com) harus diperhatikan.

## Kekuatan tarik setelah penyimpanan



## Catatan

Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat ditarik dari mereka. Pengguna memiliki satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

# WEICON Easy-Mix HT 250 Epoxy Adhesive

Sistem Resin Epoksi  
**Perekat epoksi**

## Penyimpanan

WEICON Epoxy Adhesives harus disimpan kering pada suhu ruangan. Wadah yang belum dibuka dapat disimpan pada suhu +18 °C hingga +25 °C. Hindari sinar matahari langsung. Jika petunjuk penyimpanan ini diabaikan, stabilitas penyimpanan akan berkurang menjadi 6 bulan. Secara umum, resin epoksi cenderung mengkristal pada suhu di bawah +5 °C. Efek ini diperburuk oleh fluktuasi suhu yang besar, yang dapat terjadi lebih sering selama transportasi, terutama di bulan-bulan musim dingin. Ini berdampak negatif pada pemrosesan, pengerasan, dan data teknis, tetapi dapat dibalikkan dengan pemanasan (hingga maksimum +50 °C, tanpa nyala terbuka). Pada WEICON Epoxy Adhesives, pemilihan dan kombinasi resin dasar (Bisphenol A dan F) yang cermat menjamin pengurangan kristalisasi.

## Kelengkapan Produk

Perekat | Helix Mixing Nozzle B

## Aksesoris

10005237	Dispenser Easy-Mix D 50,	1
	12747c09a5af4181802ce6072011279a	
10030395	Helix Mixing Nozzle B,	1
	12747c09a5af4181802ce6072011279a, weiß	

10101999 WEICON Manual Dispenser, 1 x 1:1 | 2:1

## Tabel konversi

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb-in
mm/25,4 = inci	Nm x 0,738 = lb-ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz-in
N x 0,225 = lb	mPa-s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

## Ukuran yang tersedia

10056568 WEICON Easy-Mix HT 250 Epoxy Adhesive, 50 ml, abu-abu muda

Catatan  
Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memiliki satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.